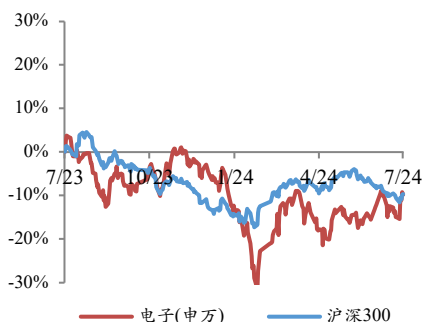


电子行业周报：三星 Galaxy AI 设备目标年底破 2 亿台， 将定制功能以重振其中国手机市场

行业评级：增持

报告日期：2024-07-14

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：陈耀波

执业证书号：S0010523060001
邮箱：chenyaobo@hazq.com

分析师：李美贤

执业证书号：S0010524020002
邮箱：limeixian@hazq.com

分析师：刘志来

执业证书号：S0010523120005
邮箱：liuzhilai@hazq.com

主要观点：

● 本周行情回顾

从指数表现来看，本周（2024-07-08 至 2024-07-12），上证指数周涨跌幅+0.7241%，深圳成指涨跌幅为+1.8232%，创业板指数涨跌幅+1.6933%，科创 50 涨跌幅为+2.7933%，申万电子指数涨跌幅+6.1209%。板块行业指数来看，表现最好的是印制电路板，涨幅为+11.11%，电子化学品表现较弱，涨幅为+3.41%；板块概念指数来看，表现最好的是先进封装指数，涨幅为+8.70%，表现最弱的是电脑硬件指数，涨幅为+0.78%。

● 三星 Galaxy AI 设备目标年底破 2 亿台，将定制功能以重振其中国手机市场

三星移动体验业务负责人卢泰文（TMRoh）在 Galaxy Unpacked 发布会后接受 CNBC 采访，表示正开发适用于中国市场的 Galaxy AI 功能，以重振三星在国内市场的占有率和影响力。

三星曾是中国最大的手机厂商，在 2013 年的市场份额约为 20%，不过目前在国内市场的份额已经不到 1%。

三星过去几年一直想要在中国市场重振旗鼓，但收效甚微，三星公司希望凭借着 Galaxy AI 的风口，吸引更多中国消费群体。

卢泰文在采访中表示：“我们正在针对中国市场，有针对性地开发 Galaxy AI 功能。我相信，通过努力创造适合中国的移动人工智能，能够满足中国消费者需求的移动人工智能，通过推进这项技术，将有助于中国市场的复苏。”

三星在会上还承诺，努力推进更多设备适配 Galaxy AI，目标今年年底运行 Galaxy AI 的设备数量超过 2 亿台。（三星，IT 之家）

● 为降低成本？古尔曼称苹果下一代 Apple Watch SE 或计划采用塑料表壳

苹果除了正在研发新一代 Apple Watch Series10 和 Apple Watch Ultra3 之外，还计划对其最实惠的 Apple Watch SE 进行重大改动：采用塑料材质打造表壳。

目前 Apple Watch SE 与其他高端 Apple Watch 一样，采用铝制表壳。苹果上次在 2022 年更新 Apple Watch SE 时，重新设计了后壳，将背面材质从陶瓷改为了新的“尼龙复合材料”。

彭博社记者马克古尔曼（Mark Gurman）在其最新一期的 Power On 通讯中透露，下一代 Apple Watch SE 可能将舍弃铝制外壳，转而采用“硬质塑料”。

虽然报告未透露更多细节，但显而易见，做出这一改变的明显好处是削减成本。如果将 Apple Watch SE 的表壳材料从铝换成塑料，理论上可以降低其售价，目前 Apple Watch SE 的起售价为 1999 元。（Mark Gurman、IT 之家）

● 中国电信 2024~2025 年服务器国产化采购比例首次过半，占比达 67.5%

中国电信服务器（2024-2025 年）集中采购项目集中资格预审公告于

7月5日发布，本次集采项目共13个标包，预估采购量15.6万台。其中，G系列（国产化系列）数量达10.53万台，占比达67.5%，突破半数大关，创历史新高。

据C114通信网援引阳光采购网的数据，早在2020年，中国电信就将全国国产化服务器单独列入招标目录，并在当年的服务器集采项目中采购近20%的国产化服务器。随后在2021年的集采中，将国产化比例提到26.7%。在2023年的AI服务器集采中，国产化的比例接近50%。（IT之家、阳光采购网）

● 引领全球车用联网模块市场，Counterpoint 预估 2028 年中国乘用车联网普及率达 100%

市场调查机构 Counterpoint Research 昨日（7月11日）发布报告，表示2020年至2030年这10年间，汽车网络接入设备（NAD）模块累计出货量将超过7亿个，预计将以13%的复合年增长率增长。目前，4GCat4接入技术主导着NAD模块市场，可满足原始设备制造商远程应用的速度要求。

然而，随着下一代SDV需求的不断增长，5G将成为L3+ADAS/ADS汽车的主导技术，而5GRedCap将取代4GCat4，用于L2ADAS及以下的联网汽车，主要集中于OEM远程信息处理和轻型流媒体信息娱乐。”

中国一直走在SDV时代的前沿，从电气化和数字驾驶舱开始，并在大多数新车中启用了自动驾驶功能。这种采用和规模不仅让中国受益，也使整个汽车价值链受益。例如，2023年，中国的NAD模块出货量占总出货量的近三分之一，在中国出货的每10辆汽车中，就有8辆实现了联网，预计到2028年，乘用车的联网普及率将达到100%。中国在5G应用方面也处于领先地位。2024年第一季度，中国出货的NAD模块中有20%具备5G功能。（Counterpoint, IT之家）

● 建议关注

AI手机方面建议关注：立讯精密、中石科技、思泉新材、艾为电子、南芯科技、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。

AIPC方面建议关注：华勤技术、春秋电子、联想集团、飞荣达、英力股份、龙芯中科、海光信息、光大同创等。

存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。

半导体设备和零部件领域建议关注：中微公司、北方华创、正帆科技等。

面板设备领域建议关注：精测电子、精智达等。

AR/VR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。

● 风险提示

需求不及预期，技术迭代不及预期

正文目录

1 本周重要细分电子行业新闻梳理	5
1.1 手机行业要闻	5
1.2 可穿戴行业要闻	8
1.3 存储行业要闻	9
1.4 面板行业和主流上游下游应用/零部件要闻	10
1.5 全球科技行业要闻	11
1.6 电脑行业要闻	17
2 市场行情回顾	18
2.1 行业板块表现	18
2.2 电子个股表现	22
风险提示:	22

图表目录

图表 1 小米手机智能工厂开始全面量产.....	5
图表 2 2024 年 Q2 中国手机市场排名.....	6
图表 3 5G 智能手机市场份额按芯片制造商分类.....	6
图表 4 5G 智能手机出货量按价格区间分类.....	6
图表 5 三星公司发布会（目标 24 年年底运行 GALAXY AI 设备超过 2 亿台）.....	7
图表 6 三星旗下首款超大容量固态硬盘 BM1743.....	9
图表 7 2021-2024Q2 中国大陆电视市场品牌季度出货量变化.....	10
图表 8 采购标包信息.....	11
图表 9 联发科、高通新旗舰晶片大战.....	12
图表 10 中国智算服务市场规模，2023H2.....	13
图表 11 中国 Top5 智算集成服务厂商市场份额，2023H2.....	13
图表 12 全球 NAD 模块出货量按技术分类，2020 年 vs 2030 年.....	14
图表 13 SEMI 2024 年中期总设备预测按细分市场.....	15
图表 14 SEMI 2024 年中期晶圆厂设备预测按应用分类.....	15
图表 15 半导体产业销售额和增长率.....	16
图表 16 NEURALINK 目标到 2026 年为超过 1000 名患者植入脑机芯片.....	17
图表 17 全球台式机 and 笔记本出货量.....	17
图表 18 全球台式机 and 笔记本出货量.....	18
图表 19 全球台式机 and 笔记本出货量（市场份额和增长率）.....	18
图表 20 板块指数.....	19
图表 21 行业板块涨跌幅和换手率（上周电子在申万一级行业指数中 1/26）.....	19
图表 22 电子行业细分板块涨跌幅和换手率.....	20
图表 23 电子行业细分产业指数精选涨跌幅和换手率.....	20
图表 24 电子行业热门细分指数涨跌幅和换手率.....	21
图表 25 电子行业行情图.....	21
图表 26 个股涨跌幅（%）.....	22

1 本周重要细分电子行业新闻梳理

1.1 手机行业要闻

(1) 小米新一代手机智能工厂全面量产，年产能 1000 万台旗舰手机

小米公司 7 月 8 日宣布，新一代小米手机智能工厂正式全面量产，这是一座行业领先的全数字化智能工厂。小米同时宣布，全新的折叠屏手机小米 MIXFold4、MIXFlip 将由此诞生，本月发布。小米这一智能工厂采用深度自研的制造装备，实现关键工艺 100% 自动化；工厂完成行业领先的“全链路工业大数据”底座建设，实现工业生产 100% 数字化。此外，该工厂采用 100% 自研的“小米澎湃智能制造平台”，作为工厂的“大脑”，让整座工厂具备了自感知、自决策、自执行能力，能够自主诊断设备问题、改进工艺流程、实现从采购原料到交付的全场景数智化管理，成为一座能自进化的真智能工厂。

雷军介绍，新一代小米手机智能工厂位于北京昌平，总投资 24 亿元，建筑面积 81000 平米，年产能 1000 万台旗舰手机。该工厂已获得“国家级智能制造标杆企业”认证。据了解，小米 2024 年落成两座智能工厂，另一座是位于北京亦庄的汽车工厂。小米即将发布的折叠屏手机 MIXFold4 将为横向折叠形态，是目前 MIXFold3 的迭代款；MIXFlip 将成为小米首款纵向“小折叠”机型。（小米、集微网）

图表 1 小米手机智能工厂开始全面量产



资料来源：小米，华安证券研究所

(2) 2024 年 Q2 中国手机市场排名：小米力压 iPhone 排名第 2，华为增长最亮眼

最新数据显示，苹果手机在中国市场销量正在衰退，而国产手机厂商正迎头赶上。据市场调研权威机构 W14-W26 最新报告显示，在 2024 年 Q2 中国手机市场排名中，vivo 以 1195 万台激活量排名榜首。其中，小米超过以 1063 万台同比增长 19.65% 的成绩力压苹果位居第 2 名。此外，榜单中还显示，OPPO（包含一加、真我）、华为和荣耀分列 4-6 名，市场份额分别是 15.17%、14.93% 和 14.93%。前六名中，华为同比增长最大，超过了 40%（达到了 42.53%）、小米、vivo 和荣耀紧随其后，分别增长了 19.65%、7.17% 和 6.93%。2023 年苹果成为全球智能手机销量第一，但在中国市场销量下滑。苹果经销商面临困境，创新乏力及国产手机品牌崛起是原因之一。之前的 618 促销中，为了提振市场份额，苹果在中国市场对 iPhone15 疯狂降价，这才换来了出货量的提升，但降价停止后这种优势也就消失了。（C114）

图表 2 2024 年 Q2 中国手机市场排名

2024年Q2中国手机市场排名

排名	品牌	24Q2 激活量(万台)	24Q2 市场份额	同比增长	23Q2 激活量(万台)
NO.1	vivo (含iQOO)	1195.06	17.93%	7.17%	1115.15
NO.2	小米 (含Redmi)	1063.16	15.95%	19.65%	888.56
NO.3	苹果	1017.73	15.27%	-1.88%	1037.27
NO.4	OPPO (含一加, realme)	1011.29	15.17%	-18.07%	1234.26
NO.5	华为	994.99	14.93%	42.53%	698.09
NO.6	荣耀	990.34	14.93%	6.93%	926.15
Others	其他	392.85	5.89%	-5.08%	413.86

* 数据来源: 2024 年, 仅统计 WW14-W26(4.1-6.30)

资料来源: C114, 华安证券研究所

(3) 2024Q1 联发科 5G 智能手机市占率位居第一, 超越高通

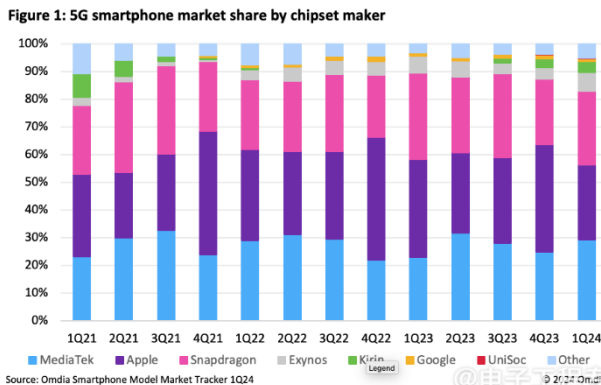
Omdia 的最新智能手机市场报告指出, 2024 年第一季度, 联发科的 5G 智能手机的 SoC 芯片组出货量超过高通, 位列第一。自 2023 年第一季度到 2024 年第一季度, 联发科在 5G 智能手机的市场份额从 22.8% 上升至 29.2%, 高通骁龙份额则从 31.2% 下降至 26.5%。

Omdia 的最新智能手机市场报告指出, 2024 年第一季度, 联发科的 5G 智能手机的 SoC 芯片组出货量超过高通, 位列第一。自 2023 年第一季度到 2024 年第一季度, 联发科在 5G 智能手机的市场份额从 22.8% 上升至 29.2%, 高通骁龙份额则从 31.2% 下降至 26.5%。

在这期间, 联发科的 SoC 芯片组实现了 53% 的强劲增长, 搭载联发科 SoC 芯片组的 5G 智能手机从 2023 年第一季度的 3470 万台增至 2024 年第一季度的 5300 万台。相比之下, 搭载骁龙的设备保持相对稳定, 出货量变化很小, 从 2023 年第一季度的 4720 万台降至 2024 年第一季度的 4830 万台。

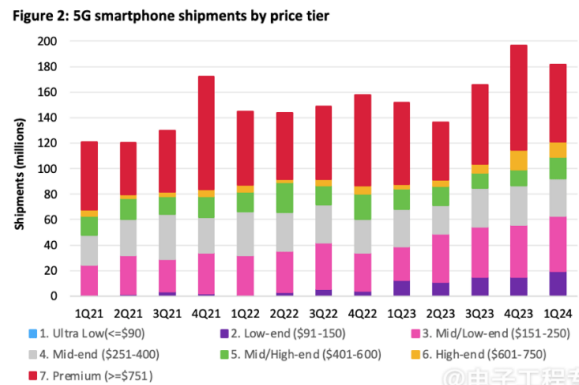
联发科在 5G 智能手机市场上超越高通, 得益于配备 5G 芯片组的 250 美元以下手机的供应量不断增加, 而这一细分市场由联发科主导。过去一年, 250 美元以下 5G 智能手机的出货量激增 62%, 从 2023 年第一季度的 3870 万部增至 2024 年第一季度的 6280 万部。(电子工程专辑, Omdia)

图表 3 5G 智能手机市场份额按芯片制造商分类



Source: Omdia Smartphone Model Market Tracker 1Q24

图表 4 5G 智能手机出货量按价格区间分类



Source: Omdia Smartphone Model Market Tracker 1Q24

资料来源: Omdia, 华安证券研究所

资料来源: Omdia, 华安证券研究所

目前，5G 智能手机 SoC 芯片组的细分明显，由联发科主导低端市场，骁龙在中端 5G 手机中处于领先地位，而苹果则在高端市场占据主导地位。联发科、高通、苹果三家已经占据了总出货量的 83%，其他芯片制造商，例如 Exynos、谷歌、麒麟和 UniSoC，合计占出货量的 17%。

Omdia 称：“智能手机芯片组行业主要受到两大趋势的影响：5G 的广泛采用和低端市场的不断扩大。随着 5G 技术变得更加实惠并集成到售价低于 250 美元的智能手机中，联发科将受益最多。相反，设备上的 AI 功能对智能手机 OEM 来说变得越来越重要，骁龙正在成为高端设备的关键创新者和首选。”

报告指出，过去三年，随着大多数芯片组制造商从生产 4G 转向生产 5G 芯片组，紫光展锐抓住机会，在下滑的 4G 市场中增加份额。紫光展锐现在是联发科在该领域的主要竞争对手。

苹果、Exynos 和骁龙的芯片组产品组合经历了重大转型，重点关注 5G 技术。Exynos 则对 4G 芯片组的依赖进行降低，从 2021 年第一季度的 77% 降低到 2024 年第一季度的 1%。相比之下，联发科的 4G 芯片组的出货量则超过 50%。（Omdia、电子工程专辑）

（3）三星 Galaxy AI 设备目标年底破 2 亿台，将定制功能以重振其中国手机市场

三星移动体验业务负责人卢泰文（TMRoh）在 Galaxy Unpacked 发布会后接受 CNBC 采访，表示正开发适用于中国市场的 Galaxy AI 功能，以重振三星在国内市场的占有率和影响力。

三星曾是中国最大的手机厂商，在 2013 年的市场份额约为 20%，不过目前在国内市场的份额已经不到 1%。

三星过去几年一直想要在中国市场重振旗鼓，但收效甚微，三星公司希望凭借着 Galaxy AI 的风口，吸引更多中国消费群体。

卢泰文在采访中表示：“我们正在针对中国市场，有针对性地开发 Galaxy AI 功能。我相信，通过努力创造适合中国的移动人工智能，能够满足中国消费者需求的移动人工智能，通过推进这项技术，将有助于中国市场的复苏。”

三星在会上还承诺，努力推进更多设备适配 Galaxy AI，目标今年年底运行 Galaxy AI 的设备数量超过 2 亿台。（三星，IT 之家）

图表 5 三星公司发布会（目标 24 年年底运行 Galaxy AI 设备超过 2 亿台）



资料来源：三星，IT 之家，华安证券研究所

1.2 可穿戴行业要闻

(1) 为降低成本？古尔曼称苹果下一代 Apple Watch SE 或计划采用塑料表壳
 苹果除了正在研发新一代 Apple Watch Series10 和 Apple Watch Ultra3 之外，还计划对其最实惠的 Apple Watch SE 进行重大改动：采用塑料材质打造表壳。

目前 Apple Watch SE 与其他高端 Apple Watch 一样，采用铝制表壳。苹果上次在 2022 年更新 Apple WatchSE 时，重新设计了后壳，将背面材质从陶瓷改为了新的“尼龙复合材料”。

彭博社记者马克古尔曼 (Mark Gurman) 在其最新一期的 Power On 通讯中透露，下一代 Apple Watch SE 可能将舍弃铝制外壳，转而采用“硬质塑料”。

虽然报告未透露更多细节，但显而易见，做出这一改变的明显好处是削减成本。如果将 Apple Watch SE 的表壳材料从铝换成塑料，理论上可以降低其售价，目前 Apple Watch SE 的起售价为 1999 元。(Mark Gurman、IT 之家)

(2) 古尔曼：苹果 Apple Watch Series10 更大更薄，新健康功能或推迟

苹果今年将对 Apple Watch 进行重大改进。最新报道称，AppleWatchSeries10 系列将拥有更大屏幕、更轻薄的设计和更快的处理器。然而，苹果在新的健康功能方面遇到了一些障碍。彭博社的马克古尔曼(Mark Gurman)在其最新一期的 Power On 通讯中透露，代号为 N217 和 N218 的两款 AppleWatchSeries10 机型今年都将采用更大的屏幕。古尔曼表示，这两款机型中较大的一款将拥有一个与 Apple Watch Ultra “差不多大”的屏幕。

这与上周曝光的示意图相吻合，该示意图显示 Apple WatchSeries10 的更大版本将配备一块 2 英寸的显示屏，略大于 Apple Watch Ultra 的 1.93 英寸显示屏。古尔曼还表示，Apple Watch Series10 将更加轻薄，但“设计本身看起来不会有太大变化”。

Apple Watch Series10 和 Apple Watch Ultra3 今年都将获得更强大的处理器。古尔曼表示，这可能“为未来的某些人工智能增强功能奠定基础”，但苹果目前“没有计划”将全套 Apple Intelligence 功能引入 Apple Watch。至于新健康功能，之前的报道称 Apple Watch Series10 将加入血压监测和睡眠呼吸暂停监测功能。彭博社的报告称，苹果去年在这方面取得了一些进展，但后来遇到了“一些严重的障碍”。

报告称，用于 Apple Watch 的血压监测技术在测试过程中“达不到预期的可靠性”，“可靠性问题可能会迫使苹果将该功能的发布推迟到今年以后。”即使该功能可用，也不会向用户显示确切的收缩压和舒张压读数。相反，该功能将显示血压随时间的变化趋势，类似于 Apple Watch 目前的体温功能。Apple Watch 据传具备的睡眠呼吸暂停监测功能与血氧饱和度数据相关。目前，由于美国国际贸易委员会(ITC)的进口禁令，苹果在美国销售的 Apple Watch 并不提供血氧监测功能。古尔曼称，苹果需要在 9 月份之前解决这个问题，或者找到一种变通的方法（也许该公司可以辩称其血氧传感器可以用于与血氧水平本身没有直接关系的用途）。苹果也可能会宣布该功能，但推迟到稍晚再发布，或者干脆完全推迟。

彭博社此前曾报道过苹果计划推出一款“Apple Watch X”，以纪念该设备 10 周年，并称这次改版将是 Apple Watch “迄今为止最大的改动”。在报告中，古尔曼表示，目前还不清楚今年的新 Apple Watch 是否会采用周年纪念版的命名，还是将更大的改版留到 2025 年发布：“目前尚不清楚苹果会将即将推出的手表命名为周年纪念版，还是等到明年发布。考虑到 Apple Watch 在 2014 年宣布，但直到 2015 年才发布，该公司可能会选择今年宣传周年纪念，或者在 2025 年推出更重磅的版本。” Apple Watch Series10 和 Apple Watch Ultra3 预计将与 iPhone16 一起在 9 月份发布。(Mark Gurman、IT 之家)

1.3 存储行业要闻

(1) 61.44TB，三星发布旗下首款超大容量固态硬盘 BM1743：搭载 176 层第 7 代 V-NAND QLC 闪存

内存和存储芯片制造商三星发布了其首款 60TB 固态硬盘，这款超大容量的固态硬盘专为企业用户设计，并非针对普通消费者市场。得益于全新主控，三星表示未来甚至可以制造 120TB 的固态硬盘。（三星）

图表 6 三星旗下首款超大容量固态硬盘 BM1743



资料来源：三星，华安证券研究所

三星以往的固态硬盘容量上限为 32TB，此次推出的 BM1743 固态硬盘则将容量提升至了惊人的 61.44TB，这款 60TB 级的固态硬盘将与 Solidigm 的 D5-P5336 和西部数据的 60TB 级企业级固态硬盘展开竞争。

BM1743 采用了三星自主研发的第七代 176 层 V-NAND(3DNAND)QLC 存储单元以及专属的主控，其顺序读取速度可达 7.2GB/s，顺序写入速度为 2.0GB/s。随机读写性能方面，BM1743 拥有 160 万次随机读取 IOPS 和 11 万次随机写入 IOPS。该款固态硬盘的耐久性为每天 0.26 次写入(DWPD)，能够持续五年。

根据三星官方消息，这款新型固态硬盘将提供两种接口规格，分别为适用于服务器的 U.2 和 PCIe4.0x4 接口。此外，针对需要更高存储密度的设备，三星还将提供支持 PCIe5.0x4 接口的 E3.S 版本。目前官方尚未公布售价和功耗等信息，不过类似规格的固态硬盘售价约为 7000 美元（当前约 50973 元人民币）。

目前三星在该细分市场将面临的竞争相对较少，因为其主要竞争对手铠侠、美光和 SK 海力士目前尚未推出 60TB 级的固态硬盘产品。（三星、IT 之家）

(2) 三星、SK 海力士探索激光解键合技术或用于 HBM4

据韩媒 etnews 报道，三星电子和 SK 海力士已经开始进行高带宽存储器（HBM）晶圆的工艺技术转换，这一转换以防止晶圆翘曲的新技术引入为核心，被认为是针对下一代 HBM。预计随着工艺转换，材料和设备供应链也将发生变化。

据悉三星电子和 SK 海力士，最近正在与合作伙伴一起开发将 HBM 用晶圆剥离（解键合）工艺改为激光方法。晶圆解键合是在工艺中将变薄的晶圆从临时载片上分离出来的工作。半导体制造过程中，主晶圆和载体晶圆是通过粘合剂粘在一起的，然后用刀片剥离，因此被称为机械解键合。

随着 HBM 的层数增加，如 12 层或 16 层，晶圆变得更薄，使用刀片分离的方法面临极限。晶圆厚度小于 30 微米时，担心会损坏晶圆，因此蚀刻、抛光、布线等工艺步骤

增加，同时需要使用适应超高温环境的新型粘合剂，这也是两家公司选择使用激光而不是传统机械方式的原因。熟悉该问题的相关行业人士解释说：“为了应对极限工艺环境，需要更强的粘合剂，而这种粘合剂无法通过机械方式分离，因此引入了激光这一新技术”，并表示“这是为了稳定地分离主晶圆和载体晶圆的尝试”。

三星电子和 SK 海力士正在考虑使用极紫外（EUV）激光和紫外线（UV）激光等多种方式。激光解键合被认为将首先引入到 16 层 HBM4。HBM4 在堆叠 DRAM 存储器的底部使用基于系统半导体的“基础芯片”，因此需要更精细的工艺和更薄的晶圆，因此激光方式被认为是合适的。

当应用激光时，相关的材料和设备供应链变化是不可避免的。现有的机械方式由日本东京电子和德国 SÜSS Micro Tec 占据市场前两位。激光方式可能会有更多的设备企业进入，预计将展开激烈的争夺战。晶圆解键合粘合剂主要由美国 3M、日本信越化学、日产化学、TOK 等供应。据悉，这些公司也在开发可以用于激光方式而不是现有机械方式的新型粘合材料。（etnews、集微网）

1.4 面板行业和主流上游下游应用/零部件要闻

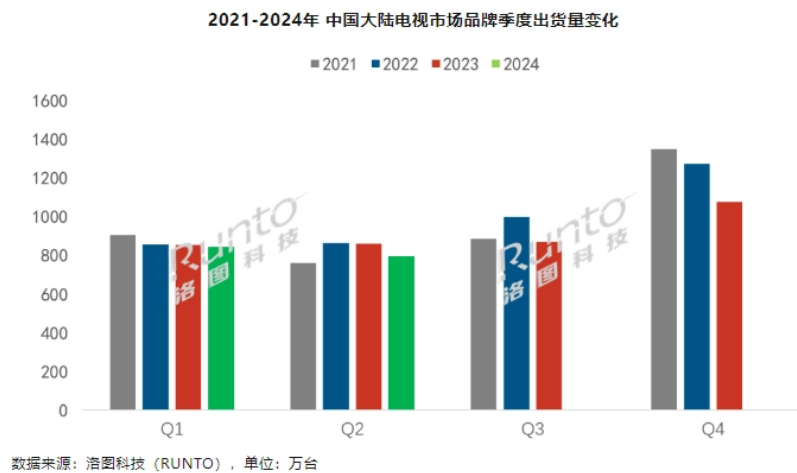
（1）洛图科技：今年上半年中国大陆电视出货量 1639 万台，同比下降 4.2%

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的数据显示，2024 年上半年，中国大陆电视市场的品牌整机出货总量为 1639 万台，同比 2023 年下降 4.2%。

其中第一、二季度的出货量分别为 844 万台和 795 万台，同比分别下降 0.9% 和 7.5%。洛图科技称，上半年，除了 1 月份的出货量实现超预期增长之外，随后的五个月份悉数同比下降。

75 英寸在线上 and 线下市场同时成为了零售量第一大尺寸，市场份额分别达到 20.6% 和 25.6%。今年上半年电视零售总额同比大幅增长约 10%，达到 522 亿元，平均单价达到 3733 元，同比增长 14.7%。（洛图科技）

图表 7 2021-2024Q2 中国大陆电视市场品牌季度出货量变化



资料来源：洛图科技，华安证券研究所

此外，在线上 and 线下市场，MiniLED 电视的销量占比分别为 7.1% 和 8.2%，同比分别大幅提升 5.2 和 3.7 个百分点。预计 2024 年全年中国市场 MiniLED 电视的出货量将达到 185 万台，同比实现连续翻倍增长。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024 年上半年，中国电视市场前 8 大品牌，即海信、小米、TCL、创维、长虹、华为、康佳、海尔以及含其子品牌的出货总量达 1557 万台，同比下降 3.7%；合计占到整体市场份额的 95.0%。

其中，海信、小米和 TCL 均以约 20%的销量市占率和微弱的差距位列市场销量前三名。

长虹、康佳和海尔三个品牌的上半年合并出货量约为 225 万台，同比下降 3.5%，合并市占率达到 13.7%。

华为上半年的出货量接近 70 万台，今年同比实现超 50%的大幅增长。

外资四大品牌索尼、三星、夏普和飞利浦的上半年出货总量不到 60 万台，合并出货量同比下降 19.5%，市占率不到 4%。（洛图科技，IT 之家）

1.5 全球科技行业要闻

(1) 中国电信 2024~2025 年服务器国产化采购比例首次过半，占比达 67.5%

中国电信服务器(2024-2025 年)集中采购项目集中资格预审公告于 7 月 5 日发布，本次集采项目共 13 个标包，预估采购量 15.6 万台。

其中，G 系列（国产化系列）数量达 10.53 万台，占比达 67.5%，突破半数大关，创历史新高。

据 C114 通信网援引阳光采购网的数据，早在 2020 年，中国电信就将全国产化服务器单独列入招标目录，并在当年的服务器集采项目中采购近 20%的国产化服务器。随后在 2021 年的集采中，将国产化比例提到 26.7%。在 2023 年的 AI 服务器集采中，国产化的比例接近 50%。（IT 之家、阳光采购网）

图表 8 采购标包信息

标包 1: 通用型服务器 (A 系列)	40705 台
标包 2: GPU 服务器 (A 系列)	6295 台
标包 3: 通用型服务器 (B 系列)	3700 台
标包 4: ARM-A 服务器 (G 系列)	63163 台
标包 5: ARM-B 服务器 (G 系列)	300 台
标包 6: ARM-C 服务器 (G 系列)	3500 台
标包 7: C86 服务器 (G 系列)	13627 台
标包 8: 混合型服务器 (G 系列)	13370 台
标包 9: GPU 服务器 (G 系列)	6840 台
标包 10: ARM-D 服务器 (G 系列)	2600 台
标包 11: 均衡型服务器 (G 系列, 要求龙芯 LoongArch 架构) A 型	600 台
标包 12: 均衡型服务器 (G 系列, 要求兆芯永丰架构) B 型	100 台
标包 13: 均衡型服务器 (G 系列, 要求申威 SW64 架构) C 型	1200 台

资料来源：IT 之家，阳光采购网，华安证券研究所

(2) 中国开源操作系统 openKylin（开放麒麟）发布 AIPC 版本

从 openKylin 公众号获悉，7 月 7 日，聚焦智能时代基础软件发展的 2024CCF（中国计算机学会）系统软件技术论坛在长沙举行，会上中国开源操作系统 openKylin（开放麒麟）推出了全新 openKylinforAIPC 版本。

openKylin 社区技术委员会委员余杰、刘晓东在会上带来《openKylinforAIPC—基于端侧大模型的操作系统智能引擎构建技术》主题报告，介绍 openKylin 社区团队在“openKylin 开源操作+九格端侧大模型”上通过在模型层、系统层、应用层的技术突破来构建 AIPC 引擎的系列实践，并演示其运行效果。

据介绍，openKylinforAIPC 版本，与 AI 技术深度融合，提供了统一的 AI 接口能力，与桌面环境无缝集成，并推出包括 AI 助手、智能文生图、智能模糊搜索等在内的一系列智能化功能，有望极大提升用户在国产操作系统上的办公效率和创作体验。特别通过应

用端侧大模型技术，将硬件和软件的深度集成，用户能够在本地独立运行复杂的 AI 任务无需依赖云端计算资源，从根本上改变和重塑用户体验。

此前 openKylin1.0 版本的发布，填补了国内在操作系统核心组件自主选型和独立构建领域的空白，推动了面向全场景的国产操作系统的迭代更新，为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。(openKylin 公众号、IT 之家)

(3) 2024Q4 对决，联发科天玑 9400、高通骁龙 8Gen4 芯片被曝已流片：台积电 3nm 工艺

根据 UDN 报道，高通骁龙 8Gen4 和联发科天玑 9400 两款旗舰芯片将于 2024 年第 4 季度同台竞技，均采用台积电的 3nm 工艺，目前已经进入流片阶段。

天玑 9400 芯片：此前消息称天玑 9400 将采用 Cortex-X5、Cortex-X4 和 Cortex-A7xx 全大核设计。相关爆料并未透露具体的 CPU 架构，但如果与天玑 9300 相似，则可能是一颗 Cortex-X5 超大核、三颗 Cortex-X4 大核和四颗 Cortex-A730 大核。联发科的天玑 9400 芯片将率先装备在 vivoX200Pro 手机上，该芯片采用台积电的 3nm 工艺制造，预估将于今年 10 月登场，成为高通骁龙 8Gen4 芯片的最强竞争对手。

高通骁龙 8Gen4 芯片：高通公司计划在第四代骁龙 8 处理器中使用台积电的 3 纳米“N3E”工艺，同时 Oryon 自研核心取代之前使用的 ARM CPU 核心，这导致该公司需要提高产品价格以收回相关成本。此前消息称骁龙 8Gen4 处理器将涨价 25%-30% 至 220-240 美元（当前约 1602-1748 元人民币），而第三代骁龙 8 处理器价格为 190-200 美元（当前约 1384-1457 元人民币）。

台积电 3nm 订单紧俏：苹果、高通、英伟达和 AMD 这 4 家公司已瓜分完台积电 3nm 系列工艺产能，导致其它厂商排队竞购，目前相关订单已经一路排到 2026 年。台积电的 3nm 系列工艺包括 N3、N3E、N3P、N3X 以及 N3A 等，台积电于去年第 4 季度开始量产 N3E 工艺，主要针对 AI 加速卡、高端智能手机等等。台积电计划今年下半年量产 N3P，预估 2026 年广泛应用在手机、消费产品、基站等产品上；N3X、N3A 则是为高速运算、车用客户等客制化打造。台积电计划 2024 年新建 7 座工厂，今年的 3nm 产能将达到去年的四倍，但可能依然无法满足市场需求。(UDN、IT 之家)

图表 9 联发科、高通新旗舰晶片大战

聯發科、高通新旗艦晶片大戰	
新晶片名稱	<ul style="list-style-type: none"> 聯發科：天玑9400 高通：驍龍8 Gen 4
預計推出時間	均於2024年第4季
主要特色	都以台積電3奈米生產，主打更高性能與AI應用等
意義	<ul style="list-style-type: none"> 聯發科天玑9400與高通驍龍8 Gen 4近期都已邁入投片生產階段，伴隨輝達、超微、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能，挹注台積電先進製程訂單熱轉 3奈米家族製程產能客戶排隊潮已一路排到2026年
資料來源：採訪整理	鐘惠玲 / 製表

资料来源：UDN，IT 之家，华安证券研究所

(4) IDC：华为字节细分领域分列第一，2023 下半年中国智算服务市场规模达 114.1 亿元、同比增长 85.8%

国际数据公司 IDC 最新发布的《中国智算服务市场（2023 下半年）跟踪》报告显示，2023 下半年中国智算服务市场整体规模达到 114.1 亿元人民币，同比增长 85.8%。

智算服务是指以 GPU、FPGA、ASIC 等 AI 专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（简称 AI IaaS）。

AI IaaS 又细分为 Gen AI IaaS（面向生成式 AI）和 Non-Gen AI IaaS（非生成式 AI，如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景）。

智算集成服务市场规模为 36.0 亿元人民币；Gen AI IaaS 市场在 2023 年从 0 到 1 爆发式增长，在下半年市场规模达到 32.2 亿元人民币；Non-Gen AI IaaS 市场规模达到 45.9 亿元人民币，以较低增速保持增长。

智算集成服务市场呈现出一超多强的特征，华为依托其领先的芯片能力及全栈服务能力，市场份额领先，前五名还有新华三、百度、寒武纪和中国电子云。

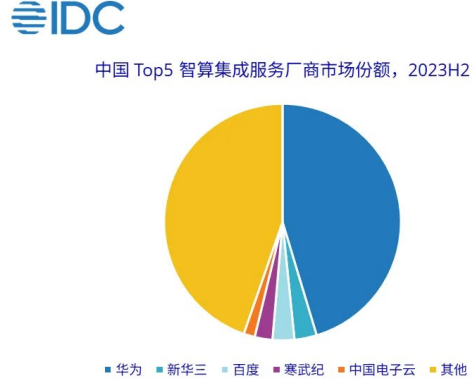
Gen AI IaaS 市场份额则较为平均，前五名分别为字节火山引擎、阿里巴巴、商汤科技、百度以及腾讯。（IDC，IT 之家）

图表 10 中国智算服务市场规模，2023H2

图表 11 中国 Top5 智算集成服务厂商市场份额，2023H2



来源：IDC 中国，2024



来源：IDC 中国，2024

资料来源：IDC 中国，华安证券研究所

资料来源：IDC 中国，华安证券研究所

(5) 消息称台积电下周开始试产 2nm 芯片，有望率先用于苹果 iPhone17 系列

据 ETNews 报道，苹果芯片代工厂商台积电将于下周开始试产 2nm 芯片，计划在明年将该技术应用于 Apple Silicon 芯片。

此次试产将在台积电位于台湾地区北部的宝山厂进行，用于 2nm 芯片生产的设备已于今年第二季度运抵该工厂。苹果预计将在 2025 年将其定制芯片转移到 2nm 制造工艺。

iPhone15Pro 使用的是采用台积电 3nm 工艺制造的 A17Pro 芯片。这种工艺可以在更小的空间内封装更多的晶体管，从而提高性能和效率。苹果最近发布的 iPad Pro 中使用的 M4 芯片采用了这种 3nm 技术的增强版。预计转向 2nm 制程将带来进一步的提升，预计性能将比 3nm 工艺提升 10-15%，功耗降低最高可达 30%。

台积电计划明年开始大规模生产 2nm 芯片，据悉该公司一直在加快这一进程，以期在量产前确保稳定的良品率，台积电目前仍然是唯一能够以苹果要求的规模和质量制造 2nm 和 3nm 芯片的公司。对于其 3nm 芯片，苹果预定了台积电所有可用的芯片制造产能，并且台积电计划在年底前将该节点的产能增加两倍以满足激增的需求。2nm 芯片预计将率先应用于 2025 年的 iPhone17 系列产品中。（IT 之家，ETNews）

(6) 马斯克脑机接口公司 Neuralink: 首位患者芯片植入物的细线现已稳定

埃隆马斯克(ElonMusk)的 Neuralink 公司的一位高管周三表示, 首位参与者体内植入的脑机接口芯片的细小电线状况现在已“差不多非常稳定”。今年5月该公司曾表示, 植入瘫痪者诺兰阿博格脑内的一根细小电线发生移位。“进行脑部手术后, 组织需要一些时间才能长入并固定住电线, 之后一切就都稳定了,” Neuralink 公司高管 Dongjin"D.J."Seo 说道。

目前, 居住在亚利桑那州的阿博格是唯一接受植入手术的患者, 但马斯克表示, 他希望今年能有更多参与者, 人数将达到“大个位数”。Neuralink 公司高管在社交媒体平台 X 上的直播中表示, 他们正在采取减轻风险的措施, 例如为患者进行颅骨塑形以及将血液中的二氧化碳浓度降低至正常水平。Neuralink 公司正在测试其植入物, 使瘫痪患者仅通过思考就能使用数字设备。该设备使用比人类头发还细的细小电线捕获来自大脑的信号, 并将其转换为诸如在电脑屏幕上移动鼠标光标等操作。

马斯克在直播中表示, 该设备不会伤害大脑。美国食品药品监督管理局(FDA)在几年前首次考虑该设备时曾提出过安全方面的疑虑, 但最终在去年批准该公司启动人体试验。到目前为止, Neuralink 的设备已经使阿博格能够仅通过思考玩电子游戏、浏览互联网并在笔记本电脑上移动光标。Neuralink 公司还正在研发一种新型设备, 他们认为这种设备只需要植入大脑一半数量的电极, 从而使其更加高效和强大。(IT之家)

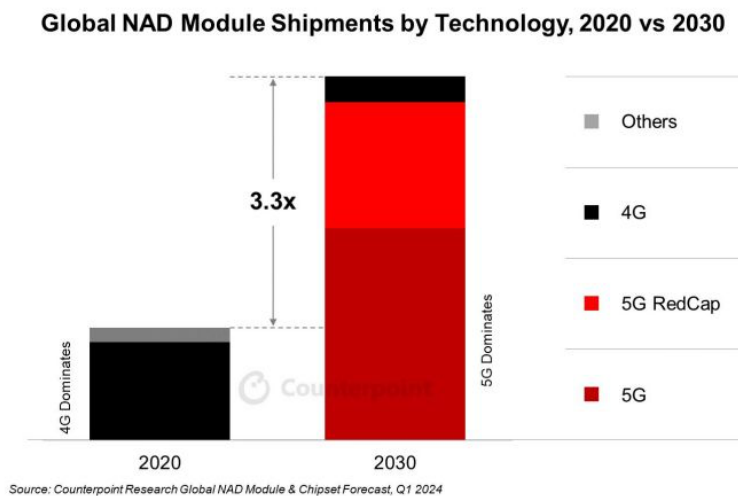
(7) 引领全球车用联网模块市场, Counterpoint 预估 2028 年中国乘用车车联网普及率达 100%

市场调查机构 Counterpoint Research 昨日(7月11日)发布报告, 表示 2020 年至 2030 年这 10 年间, 汽车网络接入设备(NAD)模块累计出货量将超过 7 亿个, 预计将以 13% 的复合年增长率增长。

Counterpoint 表示我们现在正进入汽车 2.0 时代, 其特点是动力传动系统(电气化)、安全和移动性(自主化)、驾驶舱和信息娱乐(数字化)都将发生重大变革, 而所有这些变革都将由支持软件定义汽车(SDV)的先进连接性单线程驱动。

先进的 5G 连接技术将以更高的带宽、容量和更低的延迟催化这一转变, 从而实现实时电池管理系统(BMS)、与高清/AD 地图和流式信息娱乐集成的各种基于位置的服务等功能。它还将实现低延迟 C-V2X 和数据、传感器辅助自动驾驶。

图表 12 全球 NAD 模块出货量按技术分类, 2020 年 vs 2030 年



资料来源: Counterpoint, 华安证券研究所

目前，4GCat4 接入技术主导着 NAD 模块市场，可满足原始设备制造商远程应用的速度要求。随着下一代 SDV 需求的不断增长，5G 将成为 L3+ADAS/ADS 汽车的主导技术，而 5G RedCap 将取代 4GCat4，用于 L2ADAS 及以下的联网汽车，主要集中于 OEM 远程信息处理和轻型流媒体信息娱乐。

中国一直走在 SDV 时代的前沿，从电气化和数字驾驶舱开始，并在大多数新车中启用了自动驾驶功能。这种采用和规模不仅让中国受益，也使整个汽车价值链受益。例如，2023 年，中国的 NAD 模块出货量占总出货量的近三分之一，在中国出货的每 10 辆汽车中，就有 8 辆实现了联网，预计到 2028 年，乘用车的联网普及率将达到 100%。中国在 5G 应用方面也处于领先地位。2024 年第一季度，中国出货的 NAD 模块中有 20% 具备 5G 功能。(Counterpoint, IT 之家)

(8) 2024 年半导体设备销售总额将达 1094.7 亿美元：创历史新高，环比增 3.36%

行业机构 SEMI 于美国加州时间 7 月 9 日表示，预计今年来自原始制造商的全球半导体设备销售总额将达 1094.7 亿美元 (IT 之家备注：当前约 7972.02 亿元人民币)。

1094.7 亿美元的金額较 2023 年的 1059.1 亿美元提升了 3.36%，也高于 2022 年的 1074 亿美元，为历史新高。

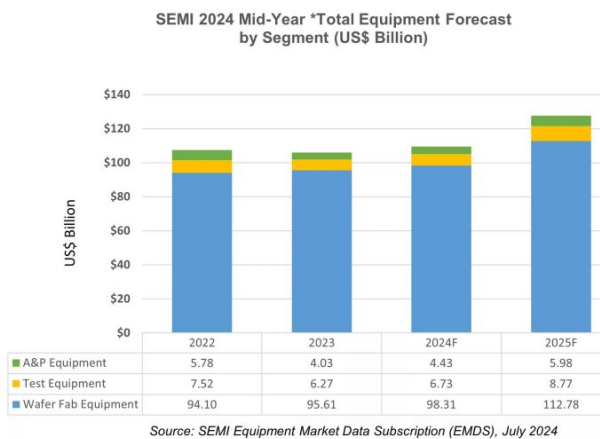
而 2025 年的半导体设备总销售额将重返快速增长轨道，达 1275.3 亿美元，较今年预期数据大增 16.5%。

从细分市场来看，晶圆厂设备领域今年呈现稳定增长态势，将达 983.1 亿美元，明显高于 SEMI 去年的预估值 930 亿美元；展望 2025 年，这部分销售额将出现 14.7% 同比增长，达 1127.8 亿美元。

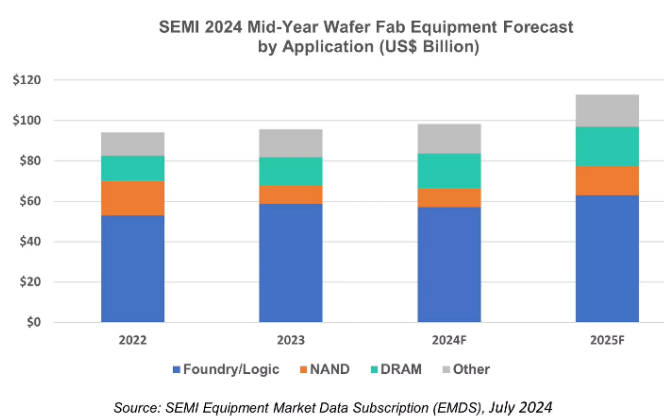
至于包含测试设备与组装和封装 (A&P) 设备的后端设备领域，也将在连续两年的萎缩后从 2024 年下半年开始出现复苏，在 2025 年录得 32.2% 的综合销售额涨幅。

而在晶圆厂设备内部，按应用划分，NAND 闪存用设备销售额将在 2023 年的大幅下滑和 2024 年的停滞在 2025 年出现 55.5% 的显著增长；DRAM 内存用设备销售额则将在今明两年录得 24.1% 和 12.3% 的稳定爬升。(SEMI)

图表 13 SEMI2024 年中期总设备预测按细分市场 (单位：十亿美元)



图表 14 SEMI2024 年中期晶圆厂设备预测按应用分类 (单位：十亿美元)



资料来源：SEMI，华安证券研究所

资料来源：SEMI，华安证券研究所

从区域来看，中国大陆 2024 年半导体设备支出将达创纪录的 350 亿美元，占全球总额的约 32%，继续巩固榜首地位，但在 2025 年会出现一定的收缩。

SEMI 总裁兼首席执行官阿吉特马诺查 (AjitManocha) 表示表示：“全球半导体行

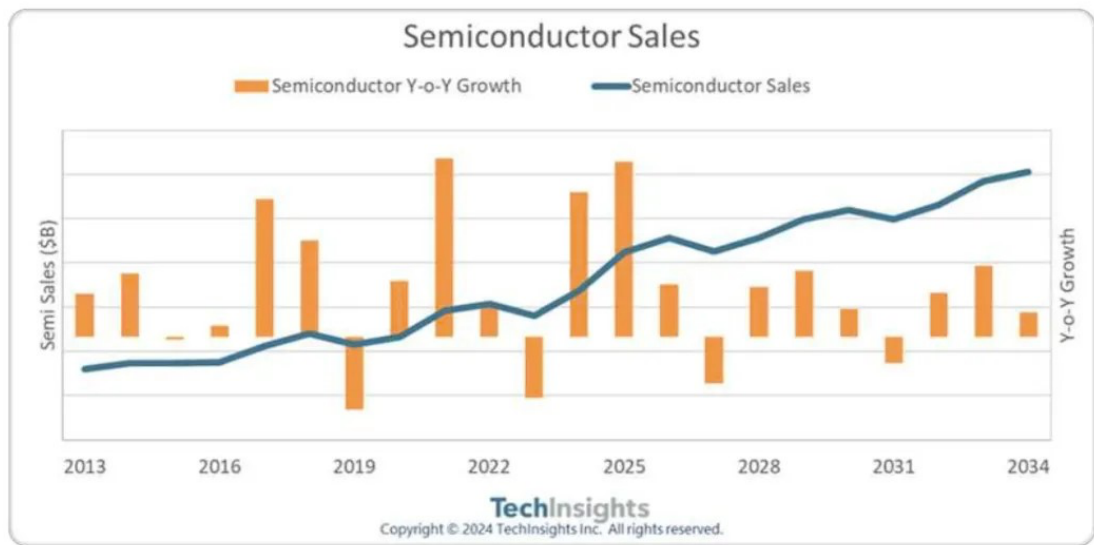
业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。”
(SEMI, IT之家)

(9) 机构：全球半导体销售额将在 2030 年破万亿美元

人工智能 (AI) 技术的迅猛发展正推动半导体产业，研究机构 TechInsights 预测，全球半导体产业销售额预计将在 2030 年达到 1 万亿美元大关；此外，预计到 2034 年，集成电路 (IC) 销售总额将达到 1 万亿美元。

根据机构预测，2025 年半导体产业将创下增长率峰值，随后在 2027 年可能出现负增长，但总体将保持波动上升趋势。

图表 15 半导体产业销售额和增长率



资料来源：TechInsights, 华安证券研究所

机构表示，在 IC 各个细分市场中，DRAM (动态随机存取存储器) 预计将呈现出最强劲的增长势头，未来十年的收入将翻一番以上。集成电路需求的激增与 AI 的广泛应用密切相关，AI 推动了半导体平均销售价格 (ASP) 的上涨，从而提高了整体收入。

除了 AI 领域，机构认为其它因素也在影响半导体产业发展轨迹，比如不断扩大的数字经济、电动汽车的兴起等。

根据美国半导体行业协会 (SIA) 预测，2024 年全球半导体销售额将达 6112 亿美元，同比增长 15.8%；世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 同样发布预测，预计这一数据增幅将达到 16.0%。(TechInsights, IT之家)

(10) 马斯克：到 2026 年，Neuralink 将为超过 1000 名患者植入脑机芯片

亿万富翁马斯克创立的脑机接口公司 Neuralink 对未来有着雄心勃勃的计划。11 日傍晚，马斯克在自家的 X (推特) 平台发文宣布，目标是到 2026 年，为超过 1000 名患者植入脑机芯片，这是可行的。

据悉，第一位植入 Neuralink 脑机芯片的人类患者 NolandArbaugh 曾公开表示，这项技术改变了自己的生活。据 IT 之家此前报道，NolandArbaugh 颈部以下曾处于瘫痪状态，在接受手术前，无法“很好地”与技术进行交互，无法使用 iPad 和口含式点击设备快速打字。而在手术后，他能够轻松使用技术设备，甚至可以玩电子游戏。

但是在今年 5 月，NolandArbaugh 脑内的一根细小电线发生移位。Neuralink 的一位高管本周三表示，首位参与者体内植入的脑机接口芯片的细小电线状况现在已“差不多非常稳定 (moreorlessverystable)”。

图表 16 Neuralink 目标到 2026 年为超过 1000 名患者植入脑机芯片



资料来源：X@ElonMusk，华安证券研究所

马斯克曾在北京时间 11 日凌晨的直播活动中透露，Neuralink 的目标是在几年内将其芯片植入数千名人类患者体内。目前看来，马斯克给这个宏大目标给出了更为具体的时间表。据介绍，Neuralink 可以让患者用大脑控制机器人的肢体，比自然的脑-肢连接更快。马斯克还表示，Neuralink 的最终目标是通过建立人类与数字智能之间的共生关系来削弱 AI 所带来的文明风险。（X@ElonMusk，IT 之家）

1.6 电脑行业要闻

(1) 英特尔 Arrow Lake-S 处理器被曝引入 NPU 芯片，算力达 13TOPS

虽然此前爆料者都认为英特尔 Arrow Lake-S 和 HX 系列处理器没有任何专用 NPU 硬件，但根据@Jaykihn 的消息，Arrow Lake-S 其实是有 NPU 模块的，只是算力不高，所以英特尔没有拿出来宣传。根据微软的标准，PC 处理器中 NPU 专用算力至少要满足 40TOPS 的要求才能被冠以 Copilot+PC 的名号，而 Arrow Lake-S 这里的 NPU 算力仅有 13TOPS，甚至还不如 CPU 部分能够提供的性能，更是远远落后于 48-50TOPS 的 StrixPoint 和 Lunar Lake 处理器。

图表 17 全球台式机 and 笔记本出货量

Jaykihn (@jaykihn0)

Collection of various small improvements/changes shipping with Arrow Lake-S.

All specifications are "up to", except for TOPS, which may exceed the listed number on the retail product.

收集各种小的改进/变化航运与 Arrow Lake-S.

所有规格都是"up to"，除了 TOPS，它可能超过零售产品上列出的数字。

Miscellaneous Changes	RPL-S	ARL-S
PCIe Hot-Plug	No	Yes
eSPI Device # Support	2	4
I2C/I3C Interfaces	8/0	6/2
DMA Audio Stream Input Support	7	10
HD Audio Bidirectional Streams	6	8
Channels Per PDM Stream	2	8
PCIe Clock Output	7	14
Imaging Clock	4	0
SRC Clock Request	10	14
GPU TOPS	3	9
NPU TOPS	0	13
CPU TOPS	8	15

上午10:09 · 2024年7月9日 · 923 查看

资料来源：X@Jaykihn，华安证券研究所

NPU 性能仅仅是 AI 能力的一部分，英特尔一般会宣传 CPU 和 GPU 的整体 AI 加速性能，例如这里 Arrow Lake 处理器中 GPU 部分的 AI 性能可达 9TOPS，CPU 部分可达 15TOPS，总计 37TOPS，虽然不如 Lunar Lake，但这已经是 Raptor Lake-S 的 3 倍。(X@Jaykihn, IT 之家)

(2) PC 市场回暖 Q2 全球出货增长 3.4%：联想、惠普、戴尔稳定前三

根据市场调研机构 Canals 的最新报告，2024 年第二季度，全球 PC 市场迎来了久违的复苏迹象。该季度全球 PC 出货量同比增长 3.4%，达到了 6280 万台，这一增长主要得益于 Windows11 的过渡更新和 AIPC 的逐步采用，预计未来几个季度更新周期将进一步加速。

图表 18 全球台式机 and 笔记本出货量



资料来源：SEMI，华安证券研究所

图表 19 全球台式机 and 笔记本出货量(市场份额和增长率)

全球台式机 and 笔记本出货量(市场份额和年增长率)
Canals PC 分析统计数据：2024 年第二季度

厂商	2024 年 第二季度 出货量	2024 年 第二季度 市场份额	2023 年 第二季度 出货量	2023 年 第二季度 市场份额	年增 长率
联想	14,724	23.4%	14,230	23.4%	3.5%
惠普	13,681	21.8%	13,444	22.1%	1.8%
戴尔	10,078	16.0%	10,329	17.0%	-2.4%
苹果	5,510	8.8%	5,198	8.6%	6.0%
华硕	4,535	7.2%	3,865	6.4%	17.3%
其他	14,280	22.7%	13,669	22.5%	4.5%
合计	62,809	100.0%	60,736	100.0%	3.4%

注：出货量单位为“千台”
由于四舍五入，百分比合计可能无法达到 100%。
来源：Canals PC 分析统计数据(出货量)，2024 年 7 月

资料来源：SEMI，华安证券研究所

在品牌方面，联想以 1470 万台的出货量继续领跑全球市场，同比增长 4%；紧随其后的是惠普，出货量为 1370 万台，位列第二。

戴尔虽然在美国市场出货量有所减少，但依然以 1010 万台的出货量排名第三，同比下降 2%。

苹果公司以 550 万台的出货量稳居第四位，市场份额占 9%，同比增长 6%；华硕凭借游戏 PC 的成功，出货量达到 450 万台，年增长率达到 17%，超越宏碁跻身前五。

PC 市场的增长得益于厂商和芯片制造商的积极推动，以及 AIPC 路线图的逐步实现。特别是首款采用骁龙处理器的 Copilot+PC 的发布，以及苹果公司发布的 Apple Intelligence 功能套件，都为市场增添了亮点。

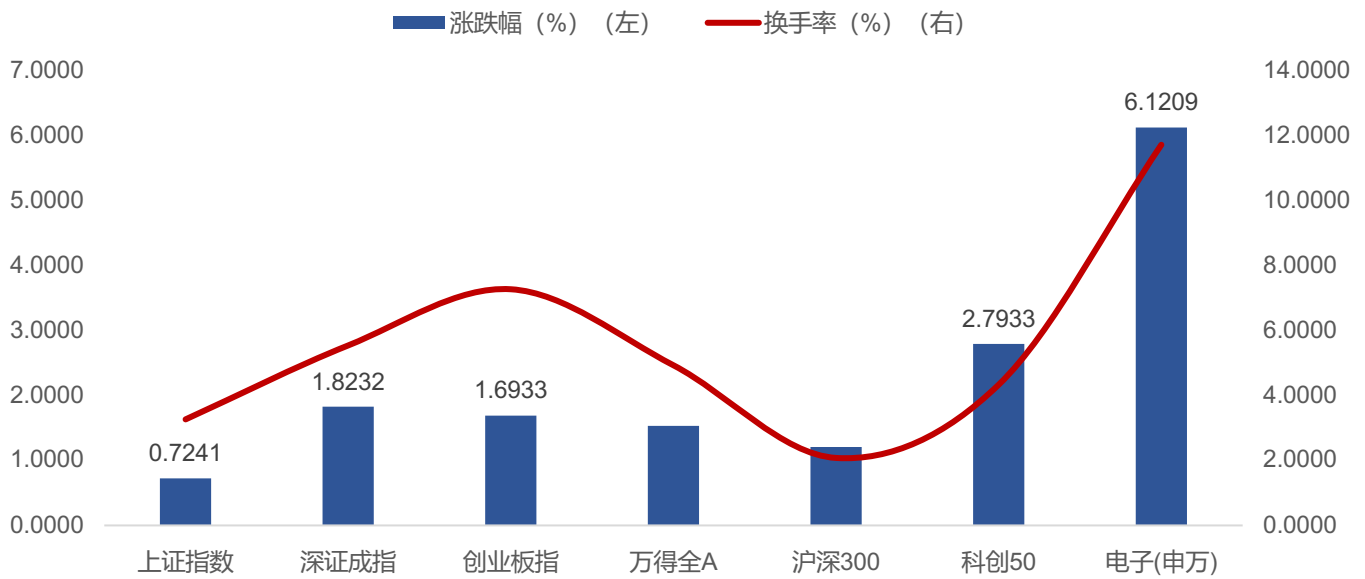
此外，Canals 在 6 月份对渠道伙伴进行的调查显示，绝大多数人认为 Windows10 服务终止将在 2024 年下半年或 2025 年上半年，预示着在接下来的几个季度中，出货量将加速增长。(Canals, C114)

2 市场行情回顾

2.1 行业板块表现

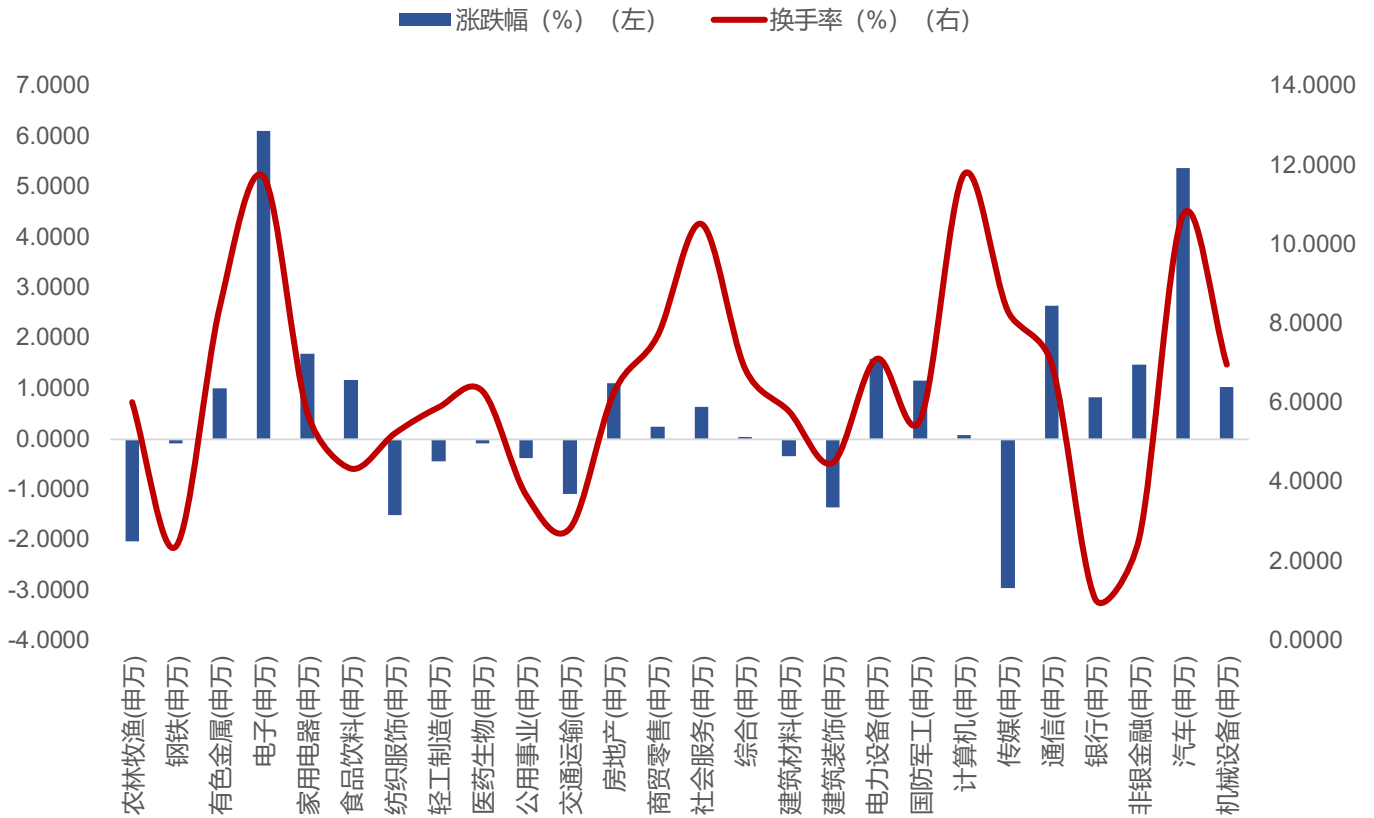
从指数表现来看，本周(2024-07-08 至 2024-07-12)，上证指数周涨跌幅+0.7241%，深圳成指涨跌幅为+1.8232%，创业板指数涨跌幅+1.6933%，科创 50 涨跌幅为+2.7933%，申万电子指数涨跌幅+6.1209%。板块行业指数来看，表现最好的是印制电路板，涨幅为+11.11%，电子化学品表现较弱，涨幅为+3.41%；板块概念指数来看，表现最好的是先进封装指数，涨幅为+8.70%，表现最弱的是电脑硬件指数，涨幅为+0.78%。

图表 20 板块指数



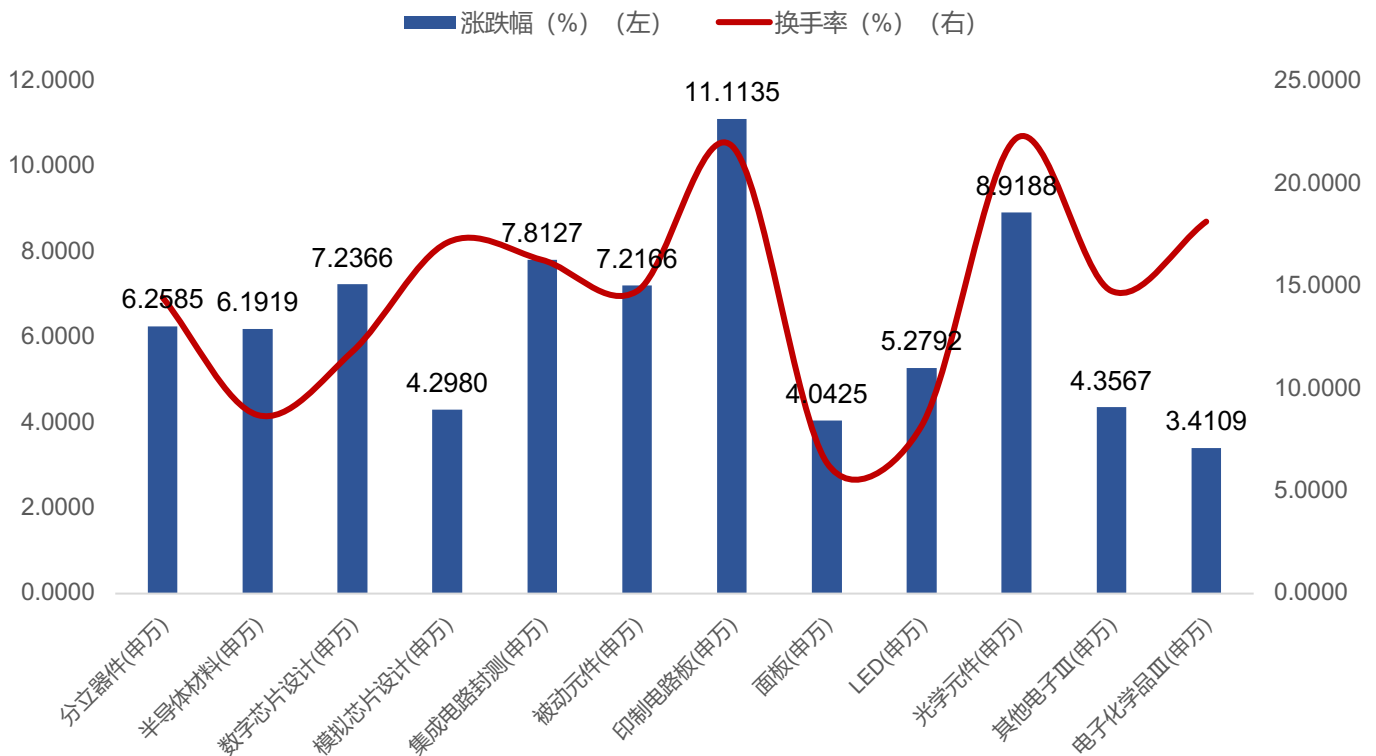
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 21 行业板块涨跌幅和换手率 (上周电子在申万一级行业指数中 1/26)



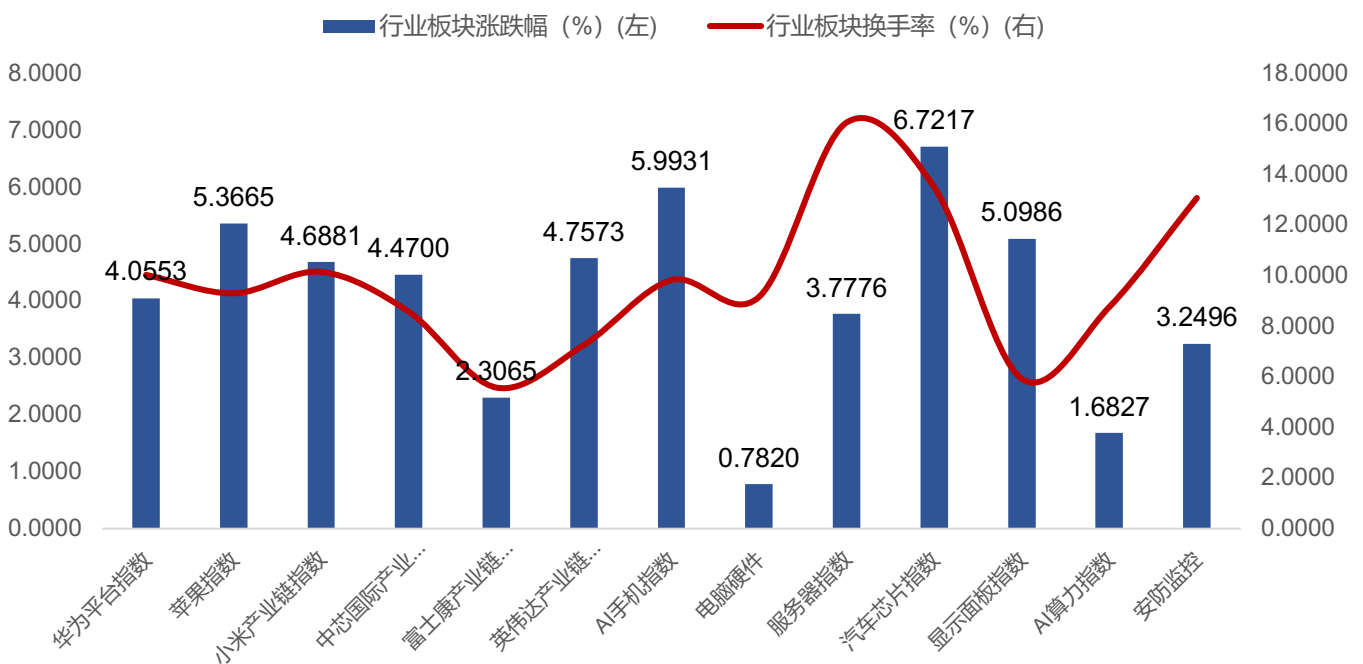
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 22 电子行业细分板块涨跌幅和换手率



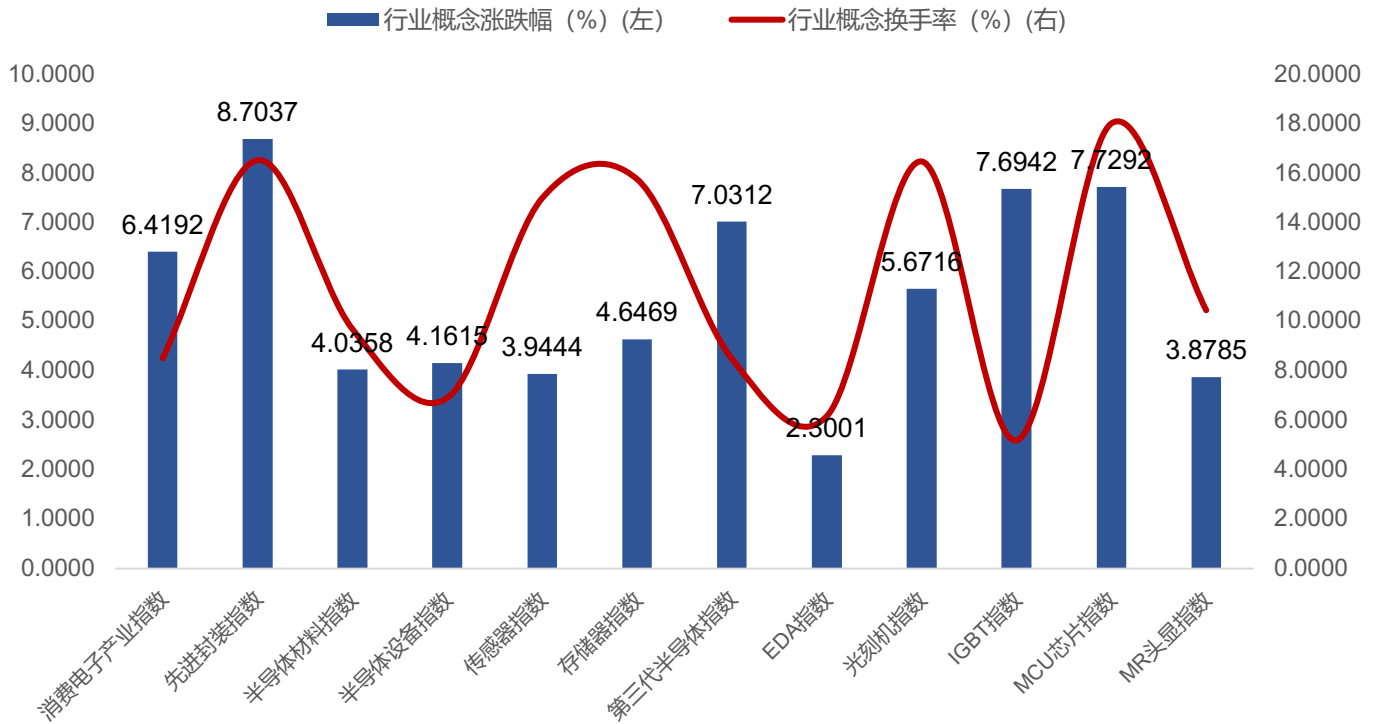
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 23 电子行业细分产业指数精选涨跌幅和换手率



资料来源: Wind, 华安证券研究所

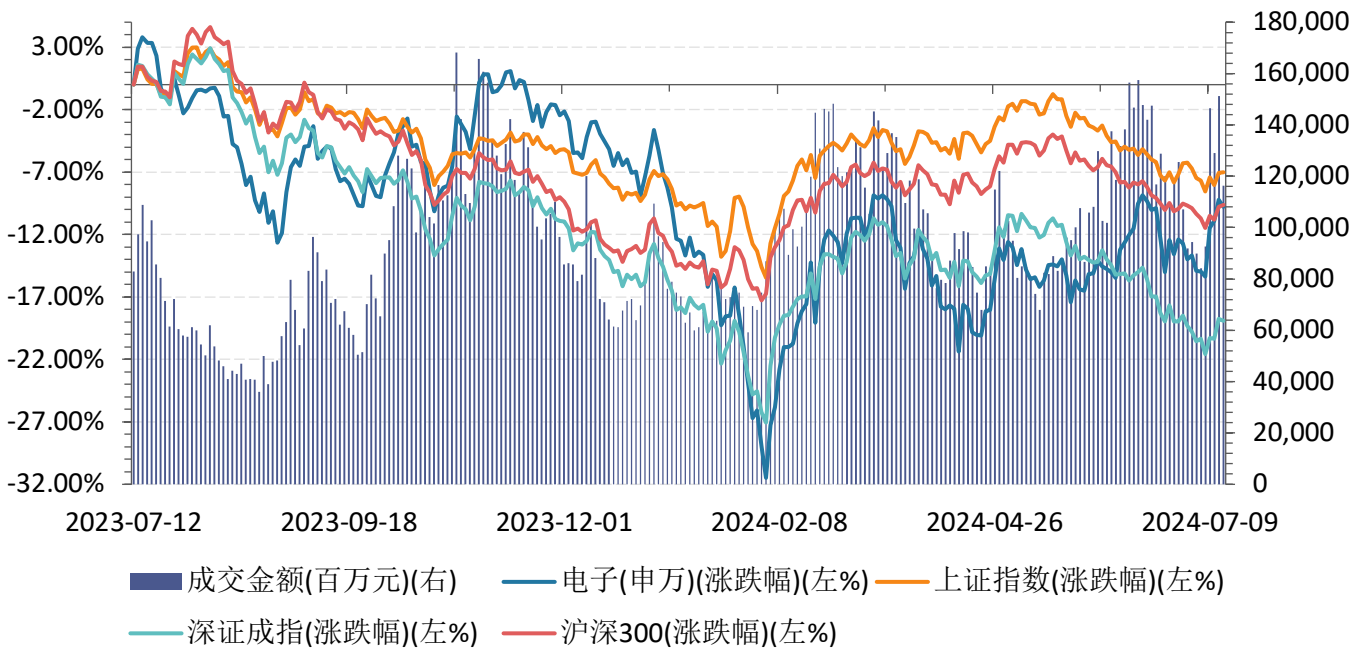
图表 24 电子行业热门细分指数涨跌幅和换手率



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 25 电子行业行情图

电子(申万)-行情图



资料来源: Wind, 华安证券研究所

2.2 电子个股表现

从个股表现看，上周表现最好的前五名分别是生益电子、朝阳科技、博硕科技、英飞特、富满微；百邦科技、纳芯微、康希通信、大港股份、源杰科技表现较弱。

从今年表现来看，表现最好的前五名分别是生益电子、胜宏科技、沃尔核材、戈碧迦、沪电股份；清越科技、慧智微-U、茂莱光学、好利科技、联建光电表现较弱。

图表 26 个股涨跌幅 (%)

周表现最好前十		周表现最差前十		今年以来表现最好前十		今年以来表现最差前十	
生益电子	44.13	百邦科技	-13.13	生益电子	146.17	清越科技	-61.28
朝阳科技	31.84	纳芯微	-12.07	胜宏科技	112.99	慧智微-U	-59.98
博硕科技	29.73	康希通信	-10.77	沃尔核材	107.88	茂莱光学	-57.94
英飞特	26.98	大港股份	-7.46	戈碧迦	95.96	好利科技	-57.30
富满微	26.87	源杰科技	-6.27	沪电股份	84.81	联建光电	-54.89
则成电子	26.79	臻镭科技	-5.32	鹏鼎控股	81.27	美芯晟	-54.76
骏亚科技	21.83	盛科通信-U	-4.92	工业富联	80.29	臻镭科技	-54.27
胜蓝股份	21.36	安集科技	-4.88	深南电路	79.48	昀冢科技	-53.76
东山精密	21.27	海航科技	-4.80	蓝思科技	51.86	炬光科技	-53.39
芯原股份	19.84	安克创新	-4.67	寒武纪-U	47.75	伟测科技	-53.09

资料来源：Wind，华安证券研究所

风险提示：

需求不及预期，技术迭代不及预期

分析师与研究助理简介

分析师：陈耀波，华安证券电子行业首席分析师。北京大学金融管理双硕士，有工科交叉学科背景。曾就职于广发资管，博时基金投资部等，具有 8 年买方投研经验。

李美贤：中国人民大学硕士，2024 年 1 月加入华安证券。曾任职于东兴证券，4 年电子及通信行业研究经验。擅长海外对标复盘，重点覆盖模拟芯片及 SoC, FPGA、GPU 等 AI 芯片相关领域。

刘志来：华安证券电子分析师。2020-2021 年曾任职于信达证券，2023 年加入华安证券。4 年电子行业研究经验，兼具买卖方视角。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。